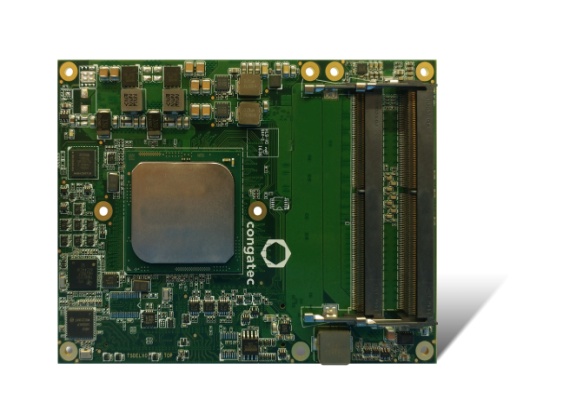
****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.com](http://www.congatec.com) | [info@sams-network.com](mailto:info@sams-network.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |

**

*Text und Foto verfügbar:* [*http://www.congatec.com/presse*](http://www.congatec.com/presse)

Pressemitteilung

**congatec präsentiert erste COM Express Typ 7 Module mit Intel® Xeon® D Prozessoren**

**Neue congatec Server-on-Modules bieten   
erstmals 10 Gigabit Ethernet Performance**

**Deggendorf, 12. Oktober 2016 \* \* \*** congatec – ein führender Technologie-Anbieter für Embedded Computermodule, Single Board Computer und Embedded Design & Manufacturing Services sowie Editor der kommenden COM Express 3.0 Spezifikation, welche auch das neue COM Express Typ 7 Pinout beinhaltet – präsentiert parallel zum Preview-Launch der COM Express Typ 7 Spezifikation neue Server-on-Module mit Intel® Xeon® D Prozessoren (Codename Broadwell). Auf Basis des weltweit führenden COM Express Basic Formfaktors (95 x 125 mm) bieten diese Module erstmals 10 Gigabit Ethernet Schnittstellen, 32 PCIe Lanes sowie Headless Serverperformance mit aktuell bis zu 16 Server-Cores und 48 GByte DDR4 ECC RAM. Applikationsfelder für die neuen Server-on-Module finden sich unter anderem in der industriellen Automatisierung und in Storage- und Netzwerk-Applikationen. Hierzu zählen unter anderem auch modulare Serverdesigns und Base Stations von Telekom-Carriern, Serverfarmen von Service Providern sowie Cloud-, Edge- und Fog-Server für IoT und Industrie 4.0 Applikationen.

Der applikationsfertige modulare Core der langezeitverfügbaren congatec Server-on-Module bietet eine Standardisierung von Footprint, Carrierboard-Interfaces und Kühlkonzept, was Systemdesigns signifikant vereinfacht, sodass neue robuste Servertechnologie schneller am Markt eingeführt werden kann. Auch machen sie zukünftige Performance-Upgrades besonders einfach und kostengünstig, da nur ein Tausch des Server-on-Moduls vorgenommen werden muss – selbst bei einem Wechsel der Prozessorarchitektur. Bei den in Carrier-Infrastrukturen eingesetzten proprietären SBC Designs und ATCA-Plattformen ist ein Upgrade ohne Modultechnologie deutlich teurer.

Christian Eder, Marketing Director bei congatec und Verfasser der COM Express 3.0 Spezifikation, die auch das neue COM Express Typ 7 Pinout beinhaltet, erklärt die hohe Relevanz der neuen Server-on-Module gemäß COM Express Typ 7 Spezifikation: „Bislang war es bei Modulen nicht möglich, 10 Gigabit Ethernet nativ auszuführen. Diese Bandbreite braucht man aber, um über Virtualisierung leicht skalierbare, modulare Server-Topologien zu schaffen. Das Typ 7 Pinout erfüllt diese Anforderungen. Es bietet bis zu vierfach 10 Gigabit Ethernet Schnittstellen sowie eine beeindruckende Anzahl von bis zu 32 PCIe Lanes, die bei solchen Servern gewöhnlich zum Anschluss von schnellen SSDs oder diskreten GPUs genutzt werden. Der Footprint von COM Express ist darüber hinaus auch sehr klein, sodass man mehr Cores pro Rack verbauen kann. Diese höchst kompakte und robuste Servertechnologie kann 10 GbE Verbindungen quasi bis ins Feld tragen, was für das Hosting vieler IoT-Applikationen von großer Bedeutung ist.“

**Das Featureset im Detail**

Die neuen conga-B7XD Server-on-Module nach COM Express Typ 7 Spezifikation sind headless ausgelegt und mit zehn unterschiedlichen Serverprozessoren verfügbar: Vom 16 Core Intel® Xeon® Prozessor D1577 bis zum Intel® Pentium® Prozessor D1519 für den industriellen Temperaturbereich (-40 °C bis +85 °C). An Arbeitsspeicher bieten sie bis zu 48 GB schnellen 2400 DDR4 Arbeitsspeicher, der je nach Kundenanforderung mit oder ohne Fehlerkorrektur (ECC) ausgestattet ist.

Das besondere Kennzeichen der neuen congatec Server-on-Module ist die hohe Netzwerkperformance mit 2x 10 Gigabit Ethernet. Sie unterstützen zudem über die NC-SI Network Controller Sideband Signale den Anschluss eines Baseboard Management Controllers (BMC) für Out-of-Band Remote Management. Für die Anbindung leistungsfähiger Systemerweiterungen inklusive Flash-Speicher führen sie zudem auch bis zu 24 PCI Express Gen 3.0 Lanes sowie 8x PCIe Gen 2.0 Lanes aus. Konventionelle Speichermedien können über 2x SATA 6G angebunden werden. Weitere I/O Interfaces wie 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, LPC, SPI, I2C Bus sowie 2x UART werden unterstützt.

Betriebssystem-Support wird für alle gängigen Linux Distributionen und Microsoft Windows Varianten geboten – Microsoft Windows 10 IoT inklusive. Umfangreiches, das Design-In erleichternde Zubehör – wie standardisierte Kühllösungen und das neue COM Express Typ 7 Carrierboard zur Evaluierung – stehen mit den Launch der neuen Module ebenfalls zur Verfügung.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozessor** |  | **Cores** |  | **Intel® Smart Cache [MB]** |  | **Clock/ Burst**  **[GHz]** |  | **TDP**  **[W]** |  | **Temperatur-bereich** |
| **Intel® Xeon® D1577** |  | **16** |  | **24** |  | **1,3 / 2,1** |  | **45** |  | **0 to +60 °C** |
| **Intel® Xeon® D1548** |  | **8** |  | **12** |  | **2,0 / 2,6** |  | **45** |  | **0 to +60 °C** |
| **Intel® Xeon® D1527** |  | **4** |  | **6** |  | **2,2 / 2,7** |  | **35** |  | **0 to +60 °C** |
| **Intel® Xeon® D1559** |  | **12** |  | **18** |  | **1,5 / 2,1** |  | **45** |  | **-40 to +85 °C** |
| **Intel® Xeon® D1539** |  | **8** |  | **12** |  | **1,6 / 2,2** |  | **35** |  | **-40 to +85 °C** |
| **Intel® Xeon® D1529** |  | **4** |  | **6** |  | **1,3** |  | **20** |  | **-40 to +85 °C** |
| **Intel® Pentium® D1519** |  | **4** |  | **6** |  | **2,1 / 1,5** |  | **25** |  | **-40 to +85 °C** |
| **Intel® Pentium® D1508** |  | **2** |  | **3** |  | **2,2 / 2,6** |  | **25** |  | **0 to +60 °C** |
| **Intel® Pentium® D1509** |  | **2** |  | **3** |  | **1,5** |  | **19** |  | **0 to +60 °C** |

Weitere Informationen zum congatec COM Express Typ 7 Server-on-Module conga-B7XD unter: <http://www.congatec.com/de/produkte/com-express-typ7/conga-b7xd.html>

Weitere Informationen zum neuen COM Express Typ 7 Pinout finden Sie im congatec Whitepaper unter: <http://www.congatec.com/de/technologien/com-express/com-express-type-7/type-7-whitepaper-registrierung.html>

**Über die congatec AG**

Mit Hauptsitz in Deggendorf, Deutschland ist die congatec AG ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren COM Express, Qseven und SMARC sowie für Single Board Computer und EDM-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, im Entertainment, im Transportwesen, bei Telekommunikation, Test & Measurement sowie Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt. Wesentliche Kernkompetenz und technisches Know-How sind besondere, erweiterte BIOS Features sowie umfangreiche Treiberunterstützung und Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec unterhält Niederlassungen in Taiwan, Japan, China, USA, Australien und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de/) oder bei [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel und Intel Xeon, Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.*